

H02S	赤外線，可視光または紫外光の変換による電力発電，例．光起電〔P V〕モジュールを使用するもの（放射線源からの電氣的エネルギーの取得 G 2 1 H 1 / 1 2；光に感応する無機半導体装置 H 1 0 F；光に感応する有機半導体装置 H 1 0 K 3 0 / 0 0；熱電装置 H 1 0 N 1 0 / 0 0；焦電装置 H 1 0 N 1 5 / 0 0）〔2 0 1 4．0 1〕	20/32	・太陽の追尾に特に適合したもの〔2 0 1 4．0 1〕
10/00	P V発電設備；電力発電のためのP Vエネルギーシステムとその他のシステムの結合〔2 0 1 4．0 1〕	30/00	光の変換に関しないP Vモジュールの構造上の細部（電解型感光装置のモジュールの半導体装置の観点 H 0 1 G 9 / 2 0，無機P Vモジュールの半導体装置の観点 H 1 0 F 1 0 / 0 0，H 1 0 F 1 9 / 0 0，有機P Vモジュールの半導体装置の観点 H 1 0 K 3 0 / 0 0）〔2 0 1 4．0 1〕
10/10	・電力の補充源を含むもの，例．ディーゼルとP Vのハイブリッドエネルギーシステム（ガスタービン設備との結合 F 0 2 C 6 / 0 0）〔2 0 1 4．0 1〕	30/10	・フレーム構造〔2 0 1 4．0 1〕
10/12	・風力とP Vのハイブリッドエネルギーシステム〔2 0 1 4．0 1〕	30/20	・折りたたみまたは折り重ね可能なP Vモジュール〔2 0 1 4．0 1〕
10/20	・エネルギー蓄積手段に特徴のあるシステム（H 0 2 S 4 0 / 3 8が優先）〔2 0 1 4．0 1〕	40/00	グループ H 0 2 S 1 0 / 0 0～H 0 2 S 3 0 / 0 0に分類されない，P Vモジュールと結合した構成部品または付属品〔2 0 1 4．0 1〕
10/30	・熱光起電システム（赤外線〔I R〕を変換または感応するために特に適合した光起電素子 H 1 0 F 1 0 / 0 0；熱電装置 H 1 0 N 1 0 / 0 0）〔2 0 1 4．0 1〕	40/10	・清掃装置〔2 0 1 4．0 1〕
10/40	・移動可能なP V発電システム〔2 0 1 4．0 1〕	40/12	・除雪手段〔2 0 1 4．0 1〕
20/00	P Vモジュールの支持構造〔2 0 1 4．0 1〕	40/20	・光学的構成部品〔2 0 1 4．0 1〕
注	太陽熱集熱器との使用を意図した支持構造もまたグループ F 2 4 S 2 5 / 0 0～F 2 4 S 3 0 / 0 0またはF 2 4 S 5 0 / 2 0に分類されるべきである。〔2 0 1 4．0 1〕	40/22	・光反射手段または集光手段（P V素子と直接結合したものまたは一体化したものの H 1 0 F 7 7 / 4 2）〔2 0 1 4．0 1〕
20/10	・地面に直接固定された支持構造（H 0 2 S 2 0 / 3 0が優先）〔2 0 1 4．0 1〕	40/30	・電氣的構成部品〔2 0 1 4．0 1〕
20/20	・固定構造物に直接固定された支持構造（H 0 2 S 2 0 / 3 0が優先）〔2 0 1 4．0 1〕	40/32	・P Vモジュール自体に結合したD C / A C変換手段，例．A Cモジュール，を備えるもの〔2 0 1 4．0 1〕
20/21	・道路に特に適合したもの，例．防音壁と一体化したもの〔2 0 1 4．0 1〕	40/34	・P Vモジュールに構造的に結合する，特に適合した電氣的接続手段，例．接続箱，を備えるもの〔2 0 1 4．0 1〕
20/22	・建物に特に適合したもの〔2 0 1 4．0 1〕	40/36	・2以上のP Vモジュール間の固有の電氣的相互接続手段に特徴があるもの，例．電氣的モジュール-モジュール接続〔2 0 1 4．0 1〕
20/23	・屋根構造に特に適合するもの〔2 0 1 4．0 1〕	40/38	・P Vモジュールに構造的に結合したエネルギー蓄積手段，例．電池〔2 0 1 4．0 1〕
20/24	・平らな屋根に特に適合したもの〔2 0 1 4．0 1〕	40/40	・熱的構成部品（H 0 2 S 1 0 / 3 0が優先）〔2 0 1 4．0 1〕
20/25	・屋根用タイル要素，例．瓦〔2 0 1 4．0 1〕	40/42	・冷却手段〔2 0 1 4．0 1〕
20/26	・P Vモジュールと一体化した建材，例．ファサード要素（H 0 2 S 2 0 / 2 5が優先）〔2 0 1 4．0 1〕	40/44	・熱エネルギーを利用する手段，例．温水および電気を同時に作り出すハイブリッドシステム（P V素子と直接結合したものまたは一体化したものの H 1 0 F 7 7 / 6 7）〔2 0 1 4．0 1〕
20/30	・可動または調節可能な支持構造，例．角度の調節〔2 0 1 4．0 1〕	50/00	P Vシステムの監視または試験，例．負荷分散または故障の確認〔2 0 1 4．0 1〕
		50/10	・P V装置，例．P Vモジュールまたは1つ1つのP V素子，の試験（製造中の半導体装置の試験 H 1 0 P 7 4 / 0 0）〔2 0 1 4．0 1〕
		50/15	・光学的手段を使用するもの，例．エレクトロルミネセンスを使用するもの〔2 0 1 4．0 1〕

99/00      このサブクラスの他のグループに分類され  
ない主題事項 [ 2 0 1 4 . 0 1 ]